

## 【复合导热硅胶垫片】规格书



- 产品图 -

## 应用特点:

- 固态、柔软可调
- 优异的绝缘效果, 耐高温
- 防火等级UL94 V-0
- 具备良好的操作性与柔韧性

## 应用领域推荐:

- 照明设备
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

## 储存条件: 阴暗处储存

储存温度:  $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度:  $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层, 而且总高度不超过1M

## 保质期:

在储存条件下: 5 年

不符合储存条件下: 6 个月

**TP-HTX800TDS 导热硅胶垫片**, 是一款柔软性好, 低出油, 超高导热的热界面材料。该产品系热传导间隙材料是以有机硅为基体, 填充导热陶瓷粉末而成, 具有更优的绝缘性、耐高温性、阻燃性。热传导间隙填充材料是填充发热器件和散热片或金属底座之间的空气间隙, 其中柔软特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面, 热量从发热器件传导到金属外壳或扩散板上, 从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命, 热传导间隙填充材料具有天然粘性, 在 $-45\sim 200^{\circ}\text{C}$ 之间能稳定工作, 在正常情况下不需要增额外的粘合剂。

## 产品性能

NO.	参 数	测试方法
颜 色	灰色	目视
厚 度 (mm)	0.3~8	ASTM D 374
硬 度 (Shore C)	20~80( $\pm 5$ )	ASTM D 2240
密 度 (g/cc)	3.3( $\pm 0.3$ )	ASTM D 792
拉伸强度 (Mpa)	$\geq 0.1_{(@\text{SC35/1mm})}$	ASTM D 412
延 伸 率 (%)	$\geq 60_{(@\text{SC35/1mm})}$	ASTM D 412
出 油 率 (%)	$\leq 1$	HFC
油 径 比 (%)	$\leq 103$	HFC
撕裂强度 (N/mm)	$\geq 0.35$	ASTM D 624
阻燃等级	V-0	UL-94
使用温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )	$-45\sim 200$	IEC 60068-2-14

## 电学特性

击穿电压 (KV)	$\geq 10_{(@1\text{mm})}$	ASTM D 149
体积电阻率 ( $\Omega\cdot\text{cm}$ )	$\geq 10^{12}$	ASTM D 257
介电常数 (@1MHz)	$\geq 3.8$	ASTM D 150
介质损耗 (@1MHz)	$\leq 0.1$	ASTM D 150

## 热学特性

导热系数 ( $\text{W/m}\cdot\text{K}$ )	8.0( $\pm 0.5$ )	ASTM D 5470
热 阻 ( $^{\circ}\text{C}\cdot\text{in}^2/\text{W}$ )	$\leq 0.27_{(@20\text{Psi/1mm})}$	ASTM D 5470

## 热阻 VS 压力(T=1mm SC35供参考)

压 力 (Psi)	10	20	30	40	50
热 阻 ( $^{\circ}\text{C}\cdot\text{in}^2/\text{W}$ )	0.252	0.220	0.196	0.180	0.161
压 缩 量 (%)	13.88	21.65	30.29	38.25	46.02

以上数据由实验室提供, 该实验室保留最终解释权